

# ポリイミドフィルムを基材とした薄型部品内蔵基板

中尾 知\*

**Polyimide Multilayer Circuit Board Embedded with Active and Passive Devices**

Osamu NAKAO\*

---

\* 株式会社フジクラ (〒 285-8550 千葉県佐倉市六崎 1440)

\* Fujikura Ltd. (1440, Mutsusaki, Sakura-shi, Chiba 285-8550)